

(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES  
PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum  
Internationales Büro



(43) Internationales Veröffentlichungsdatum  
21. Oktober 2004 (21.10.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer  
**WO 2004/090523 A1**

(51) Internationale Patentklassifikation<sup>2</sup>: **G01N 27/22**

[AT/AT]: Dambergschlag 23, A-4170 Hirschbach a. d. Mühl  
(AT).

(21) Internationales Aktenzeichen: **PCT/EP2004/003278**

(74) Anwalt: **HOFMANN, Ernst; Dr. Johannes Heidenhain**  
GmbH, Patentabteilung, Postfach 12 60, 83292 Traunreut  
(DE).

(22) Internationales Anmeldedatum:  
27. März 2004 (27.03.2004)

(81) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare nationale Schutzrechtsart): AE, AG, AI,  
AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH,  
CN, CO, CR, CU, CZ, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI,  
GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE,  
KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD,  
MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG,  
PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM,  
TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM,  
ZW.

(25) Einreichungssprache: **Deutsch**

(84) Bestimmungsstaaten (soweit nicht anders angegeben, für  
jede verfügbare regionale Schutzrechtsart): ARIPO (BW,  
GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM,

(26) Veröffentlichungssprache: **Deutsch**

*[Fortsetzung auf der nächsten Seite]*

(30) Angaben zur Priorität:  
103 16 933.4 12. April 2003 (12.04.2003) DE

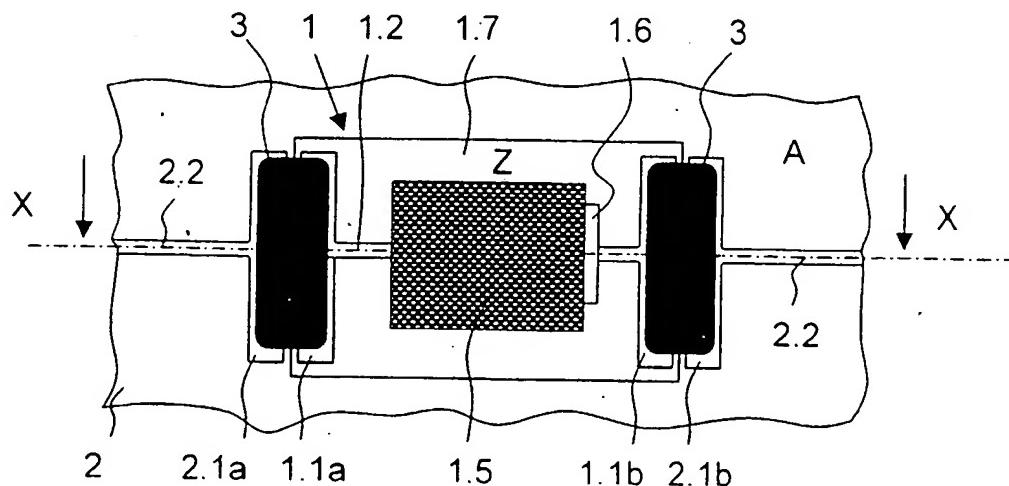
(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von  
US): **E+E ELEKTRONIK GES.M.B.H. [AT/AT]; Lang-**  
wiesen 7, A-4209 Engerwitzdorf (AT).

(72) Erfinder; und

(75) Erfinder/Anmelder (nur für US): **LINDORFER, Gerald**

(54) Title: SENSOR SYSTEM AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME

(54) Bezeichnung: SENSORSYSTEM UND VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG



(57) Abstract: The invention relates to a sensor system consisting of a thin-film sensor (1) provided with at least one contact area (1.1 a, 1.1 b) on the surface (Z) thereof, and a printed circuit board (2) provided with at least one contact pad (2.1 a, 2.1 b) on the surface (A) thereof. The thin-film sensor (1) is arranged in relation to the surface (A) of the printed circuit board (2) such that the surface (Z) of the thin-film sensor (1) opposes the surface (A) of the printed circuit board (2). In order to transmit sensor currents from the thin-film sensor (1) to the printed circuit board (2), a conductive glue (3) adheres to both the contact area (1.1 a, 1.1 b) of the thin-film sensor (1) and to the contact pad (2.1 a, 2.1 b) on the surface (A) of the printed circuit board (2). The invention also relates to a method for producing one such sensor system.

*[Fortsetzung auf der nächsten Seite]*

WO 2004/090523 A1

01/202016112



ZW), eurasisches (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), europäisches (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, PT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BE, BJ, CH, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("*Guidance Notes on Codes and Abbreviations*") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

**Veröffentlicht:**

— mit internationalem Recherchenbericht

---

**(57) Zusammenfassung:** Die Erfindung betrifft ein Sensorsystem, welches aus einem Dünnschichtsensor (1) mit mindestens einer Kontaktierungsfläche (1.1 a, 1.1 b) an dessen Oberfläche (Z) und einer Leiterplatte (2) mit mindestens einem Kontaktpad (2.1 a, 2.1 b) auf deren Oberfläche (A) besteht. Dabei ist der Dünnschichtsensor (1) bezüglich der Oberfläche (A) der Leiterplatte (2) so platziert, dass die Oberfläche (Z) des Dünnschichtsensors (1) der Oberfläche (A) der Leiterplatte (2) abgewandt ist. Zum Übertragen von Sensorströmen vom Dünnschichtsensor (1) auf die Leiterplatte (2) haftet ein Leitkleber (3) sowohl an der Kontaktierungsfläche (1.1 a, 1.1 b) des Dünnschichtsensors (1) als auch am Kontaktpad (2.1 a, 2.1 b) auf der Oberfläche (A) der Leiterplatte (2). Die Erfindung umfasst weiterhin ein Verfahren zur Herstellung eines derartigen Sensorsystems.